

平成 26 年度事業報告書

自：平成 26 年 4 月 1 日 至：平成 27 年 3 月 31 日

1. 全般

- (1) 大会事業については、計画通り、国際会議 ICEP 2014、第24回マイクロエレクトロニクスシンポジウム (MES2014)、2014ワークショップ、第29回春季講演大会を開催した。いずれの事業も前年同様の発表、参加者を集め、補助金の効果も加わって、大幅な収支改善となった。
- (2) 展示会事業については、JPCA Showと同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、eX-techを企画・運営し、産学共同の情報交流の場を提供するとともに展示会集客にも貢献した。
- (3) 技術調査事業については、昨年度から継続した13技術委員会、23研究会の体制で、技術情報交換、人的交流を深めた。また、最新技術動向について、公開研究会や学会誌特集記事を通じて広く情報発信した。今年度、新たに、カーエレクトロニクス研究会、パワーエレクトロニクス研究会、ヘルスケアデバイス実装技術研究会の3研究会を設置し活動を開始した。
- (4) 教育事業については、計画通り、PWB製造初級コース、実装技術総合基礎講座、伝熱解析セミナー (初級、中級) の3つの教育講座と2つ (第60回、61回) の教育セミナーを実施した。
- (5) 会誌発行事業については、学会誌 7回および英文論文誌1回を発行した。広告収入が対予算比、大幅に減少し収支悪化した。
- (6) 国際事業については、国際会議ICEP-IAAC 2015開催に係る IEEE CPMT Society Japan Chapter、IMAPSとの連携関係を確認するため、双方とそれぞれMOUを締結した。実装技術の分野で、2大国際学会となっているICEP と ICSJ(旧 VLSI Packaging Workshop)の今後の協調に関して意見交換を行った。
- (7) 支部事業については、関西支部では、計画通り若手研究会セミナー2回、技術講演会1回、関西ワークショップ1回、ぷらっと関西1回を開催した。九州支部では、九州大学バイオメカニクス研究センターと合同研究会を開催した。また、東北・北海道支部設立へ向けた準備を開始した。
- (8) 表彰事業については、例年どおり、エレクトロニクス実装技術分野の学術・技術的な進歩発展への貢献や学会の発展・運営に貢献した方々を表彰した。各大会の優秀発表を表彰した。
- (9) 平成26年3月から17名でスタートしたミッションフェローは、学会活性化に向けた今後の取組みについて、メンバー相互や理事会メンバーと議論し、意識を共有した。ミッションフェローが中心となり、MESでのミッションフェローセッション、講演大会でのイベント企画、大会運営を推進した。
- (10) 産業界と連携において重要なパートナーであるJPCAと情報共有、意見交換、活動活性化を図るため、定期的にJPCAとの戦略会議を開催した。

2. 学会運営体制

(1) 公益目的支出計画変更認可

平成26年度完了の予定で進めてきた公益目的支出計画について、平成26年度収支改善状況に基づき、平成27年度完了への変更認可申請を行い3月16日付けで認可された。

(2) 財務体質の安定化

持続可能な学会運営体制構築を目指して、大会事業、技術調査事業、教育事業、会誌発行事業、支部事業を中心に、収益改善、費用削減に取り組んだ。また、事務局リソースの削減・変動対応化、事務局サービスのスリム化効率化に着手した。

(3) 会員数の増強

【第1号議案】

潜在的な候補者を掘り起こす新規入会促進キャンペーン「JIEP+α 100キャンペーン」を行った。キャンペーン適用で36名が入会した。

3. 大会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「国際会議 ICEP-IAAC 2014」（組織委員長 石塚勝学長 富山県立大学）

2014. 4. 23～25、富山国際会議場にて、IEEE CPMT Society Japan Chapter、IMAPS と共催で「国際会議 ICEP-IAAC 2014」を開催した。以下のkey note speechがあった。

“Development of Autonomous Driving Technologies and its future”

Ryota Shirato, Nissan Motor Company

“Hybrid Memory Cube: The New Standard for Memory Performance”

Scott Graham, Micron Technology, Inc.

“Introducing the latest 3D printing technology and applications”

Nave Rachman, Stratasys Asia Pacific & Japan

“Implementation of high-volume genomic analyses by microfluidics/microchip technologies: Towards integrative medical sciences for preventive medicine”

Osamu Ohara, Kazusa DNA Research Institute;

RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS-RCAI)

“Gen-3 Embedded Cooling: Completing the Inward Migration of Thermal Packaging”

Avram Bar-Cohen, DARPA-MTO

総計 186 件(Keynote 5 件含む)の口頭発表、27 件のポスター発表があった。発表者も含めた参加者は 362 名。

(2) 「第 24 回秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム」（組織委員長 伊達仁昭氏 富士通クオリティ・ラボ）

2014. 9. 4～5、大阪大学 吹田キャンパスにて開催した。講演 103 件（招待講演、依頼講演、ものづくりセッション含む）の発表があった。パワーエレクトロニクスの企画セッションが好評で、ミッションフェローセッションも開催した。また、「混沌の世界の中で日本の生きる道を考える」（真田幸光教授 愛知淑徳大学）、「次世代パワーエレクトロニクス技術開発の潮流」（奥村 元氏 産業技術総合研究所）の招待講演を行った。参加者は 464 名。

(3) 「2014 ワークショップ」（実行委員長 山道新太郎氏 日本アイ・ビー・エム）

「日本ブランド復権のカギを握る実装イノベーション ～ 魅力ある機能・品質・コストへの挑戦～」をテーマに、ラフォーレ修善寺にて、2014. 10. 23～24 で開催した。特別講演「マイクロ・ナノ医療デバイスの実装技術」（三木則尚准教授 慶應義塾大学）及び、ナイトセッション「魅力ある機能、品質でいかに儲けるか ～“時間制御”にメスを入れた、ものづくりの全体最適化」（西岡潔特任教授 東京大学）を実施した。発表 41 件、参加者は 73 名。

(4) 「第 29 回春季講演大会」（講演大会組織委員長 染谷隆夫教授 東京大学）

東京大学 本郷キャンパスにて、2015. 3. 16～18 で開催した。特別講演は「Additive Manufacturing 技術の現状と展望」（新野俊樹教授 東京大学）、「トリリオン・センサの動向と、産業界、学界のやるべきこと」（神永晋エグゼクティブシニアアドバイザー 戦略会議議長 SPP テクノロジーズ株式会社（前住友精密工業株式会社社長））の 2 件。さらに、カーエレクトロニクス特別セッション基調講演として「カーエレクトロニクスの歴史俯瞰と電動化、情報化、自動化時代を迎えて」（加藤光治ファウンダー・代表取締役 株式会社サイロックス（元株式会社デンソー専務取締役））を実施。一般講演 129 件、依頼講演 25 件、ポスターセッション 17 件、ものづくりセッション 22 件、チュートリアル 6 件であった。参

【第1号議案】

加者は618名。今回初めての企画として、ミッションフェローが中心となり、学生／企業交流会を開催した。参加者は企業26社、学生22名。

4. 展示会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

(1) 「最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、eX-tech 2014」

JPCA Show（2014.6.4～6、東京ビッグサイト）と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、eX-tech 2014を実施した。最先端実装技術シンポジウムは12セッション36講演を実施し、聴講者は延べ455名だった。アカデミックプラザは39件の発表があり聴講者は延べ734名。また2件のアカデミックプラザ賞を授与した。eX-tech2014には12社の出展があった。

(2) 「セミコン・ジャパン 2014 への展示」

2014.12.3～5 東京ビッグサイトにて開催したセミコン・ジャパン 2014に、当学会活動を紹介するパネル5枚、H25年度の技術賞、論文賞のパネル各2枚を展示した。ブース来場者は延べ600名。

5. 技術調査事業活動報告（定款第4条第2号関係）

(1) 技術委員会の活動

前年に続き、13の技術委員会を組織し、実装技術分野の技術動向を調査し、「エレクトロニクス実装技術の現状と展望」と題した特集記事を学会誌1月号に掲載した。大会事業や展示会事業に委員を派遣し、各イベントの企画運営を支援した。

(2) 研究会の活動

4月の公開研究会をもって終了した「錫ウイスカ研究会」を含め、各技術委員会の傘下に合計23の研究会を組織し、具体的な個々の実装技術テーマについて、調査活動を行い委員相互の情報交換を行った。エレクトロニクス実装技術領域の変化に対応するため、新しい分野に対応するため、3つの新研究会（カーエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス、ヘルスケアデバイス実装技術）を新たに設置し、活動を開始した。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果については、公開研究会や学会誌などで広く公開した。開催した公開研究会等は以下のとおり。

延べ開催回数：35回、延べ参加人数：1,920人

担当研究会等	開催日	会場	参加人数	概要
錫ウイスカ研究会	4/18	回路会館	50	「高信頼性鉛フリーめっきと錫ウイスカ対策」
部品内蔵技術委員会 (1)	7/10	回路会館	86	「部品内蔵基板と高密度化を支える実装技術」をテーマに講演を5件。
〃 (2)	9/19	回路会館	89	「部品内蔵基板と高密度化を支える実装材料」をテーマに講演を5件。
〃 (3)	11/21	回路会館	58	「海外における部品内蔵基板、及び周辺技術の最新技術動向」をテーマに講演を5件。
〃 (4)	2/13	回路会館	74	「部品内蔵基板と高密度化を支える実装材料2」をテーマに講演を5件。
機能性ハイブリッド材料研究会 (1)	1/29	回路会館	約40	「エコ社会に貢献するパワーデバイスの実装技術と材料技術」をテーマに講演4件。
システム実装	6/3	回路会館	36	「未来の産業を支えるシミュレーション技術」を

【第1号議案】

-CAD/CAE 研究会 (1)				テーマ、「クルマ関係への応用を狙ったシミュレーションと理論的解釈」をサブテーマに講演4件。製品技術紹介1件。
〃 (2)	12/5	回路会館	24	「未来の産業を支えるシミュレーション技術」をテーマに、「ワイヤレス給電と制御」をサブテーマに講演5件。
サマーセミナー	8/26	機械振興会館	110	『あなたの「もやもや」 スッキリ解決!? パワエレの EMC』をテーマに講演7件。
低ノイズ研究会 (1)～(8)	6月より 11月	回路会館	48	EMC 設計技術実践講座(8回)
超高速・高周波エレクトロニクス実装研究会(1)	5/16	回路会館	15	「マイクロストリップラインを用いた平面形 HPF の設計に関する一検討」など講演3件、製品技術紹介1件。
〃 (2)	8/1	横浜商工会議所	43	「プリント配線基板における伝送線路モデルのフィッティング手法の検討」など講演6件。
〃 (3)	11/14	回路会館	56	「可変容量構造による反共振ピークの Q 値の抑制手法」など講演6件、製品技術紹介2件。
マイクロ・ナノアプリケーション研究会 (1)	7/16	回路会館	75	「次世代半導体パッケージ技術の最新動向」をテーマに講演4件。
〃 (2)	10/3	回路会館	82	「スマホ・タブレットの半導体パッケージ用材料・プロセスの最新技術動向」をテーマに講演5件。
〃 (3)	12/16	回路会館	107	「パワーエレクトロニクスの最新技術動向」をテーマに講演5件。
次世代配線板研究会 (1)	10/15	回路会館	65	「3D プリンタ・3D-MID 技術の進化で膨らむ筐体配線実装への期待」をテーマに講演2件、製品技術紹介3件。
〃 (2)	2/2	回路会館	88	「2. 1D、2. 5D 実装の最新技術動向」をテーマに講演5件。
先進実装・電子部品技術研究会、プリンタブルデバイス研究会共催(1)	6/17	関東学院大学	53	材料・表面工学研究所の主要研究内容紹介と見学会を実施。講演5件。 プリンタブルデバイス研究会と合同実施。
〃 (2)	11/18	東京大学	38	「プリントド技術の実用化に向けた課題」をテーマに講演4件。 プリンタブルデバイス実装研究会と合同開催。
先進実装・電子部品技術研究会 (3)	12/15	回路会館	51	「MEMS・センサ部品の技術動向」をテーマに講演4件。
先進実装・電子部品技術研究会 (4)	2/20	横浜国立大学	45	C-NET・先進実装・電子部品研究会と共催の公開研究会の実施。
ボードテスト技術研究会	1/23	回路会館	37	「競争力のあるものづくり～しんか(進化・深化・真価)を求める検査～」をテーマに講演5件、パネルディスカッション。
光回路実装技術研究会 (1)	7/9	回路会館	91	「高密度光インターコネクタのためのコネクタ技術開発動向」をテーマに講演4件。
〃 (2)	11/7	慶應義塾大学	60	「ポリマー光導波路技術開発動向」をテーマに講

【第1号議案】

		矢上キャンパス		演 4 件。
〃 (3)	1/30	回路会館	65	「並列光伝送モジュールの開発動向」をテーマに講演 4 件。
環境と実装研究会 (1)	5/29	回路会館	30	「光利用環境技術」－FEL, OLED の現状と植物工場に見る実装の課題－をテーマに講演 4 件。
〃 (2)	2/23	回路会館	30	「環境配慮プロセス、省エネプロセス、リサイクル」をテーマに講演 4 件。
システムインテグレーション実装技術研究会 (1)	10/30	回路会館	72	「システムから見る実装技術～求められる新しいアーキテクチャから次世代実装技術を探求する～」をテーマに講演 6 件。
〃 (2)	2/19	回路会館	80	「半導体のスケーリング則終焉が議論されている今、実装技術者は何をしなければならぬのか？」のテーマで講演 5 件、パネルディスカッション。
サーマルマネジメント研究会 (1)	1/22	回路会館	35	「HEV/EV 向けパワーエレクトロニクスの技術開発動向」など講演 3 件、パネルディスカッション
官能検査自動化研究会 (1)	7/30	回路会館	31	「検査における画像化と視覚の定量化に関する最新技術動向－見えないもの・見えにくいものを捉える－」をテーマに講演 4 件、製品技術紹介 2 件。
〃 (2)	1/28	回路会館	38	「競争力のあるものづくりを目指して －官能検査自動化に関する最新技術動向：高速化、可視化、定量化、及び共通化－」をテーマに講演 3 件、製品技術紹介 2 件。
標準化状況調査研究会 (1)	12/17	回路会館	18	「国際標準化の進展」をテーマに講演 3 件、「実装技術の規格化・標準化への取り組み」をテーマに講演 2 件。
ヘルスケア研究会 (1)	1/15	MMC	50	「ヘルスケアデバイスの実装を考える」をテーマに講演を 4 件。

6. 教育事業活動報告（定款第 4 条第 3 号関係）

(1) 教育講座の実施

①PWB 製造・初級コース（2014. 6. 26～27 回路会館）

新入社員、営業担当者向けに、広い技術分野にまたがるプリント配線板について、基礎知識の修得を目標とした初級コースの教育講座を実施した。受講者は 28 名。

②第 14 回実装技術総合基礎講座（2014. 11. 12～13 回路会館）

企業で実装技術に関わる中堅技術者や、これから実装技術に関わる異分野の技術者を対象として、実装技術総合講座を実施した。受講者は 30 名。

(2) 教育セミナーの実施

①第 60 回セミナー（2014. 10. 14 回路会館）

基調講演「フレキシブル医用デバイスと実装技術」（染谷隆夫教授 東京大学）ほか一般講演 4 件を実施した。受講者は 31 名。

②第 61 回セミナー（2015. 2. 10 回路会館）

基調講演「微細印刷技術の進展とフレキシブル有機デバイスへの応用展開」（時任静士教授 山形大学）ほか一般講演 4 件を実施した。受講者は 25 名。

【第1号議案】

(3) 伝熱解析セミナーの実施

① 初級編 (2014. 10. 27 回路会館) / 中級編 (2015. 2. 9 回路会館)

表計算ソフトを使う演習を中心にした伝熱解析セミナーの初級編と中級編とを実施した。伝熱解析の基礎と演習の初級編と中級編。広島国際大学・大串哲郎教授により指導。実際にエクセルファイルを使用し、受講者自ら課題に取り組む。受講者は初級編 27 名、中級編 25 名。

7. 会誌発行事業活動報告 (定款第 4 条第 4 号関係)

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を 7 回発行した。研究開発活動の成果として研究論文、速報論文、技術報告等を掲載し、実装技術に関する最新情報を会員に提供した。編集委員会企画特集号 (9 月号) では「パワーエレクトロニクス」をテーマに設計、実装技術、放熱・熱抵抗測定、電気鉄道への応用までの分野について 7 件の特集記事を掲載した。また、理事会はじめ学会活動状況についても広報した。

(2) 英文論文誌の発行

論文数 17 件を掲載した英文論文誌 Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol. 6 を 2013 年 12 月に発行した。学会英文ホームページ及び J-STAGE (科学技術振興機構の総合電子ジャーナルプラットフォーム) から一般閲覧できるようにした。J-STAGE からのダウンロード数は月間 1,000 件前後。

(3) 韓国語翻訳転載

学会誌の解説記事および論文のうち 38 件が、雑誌「表面実装技術」(韓国 尖端社 発行) に翻訳転載され、国際普及が進められた。また、従来は冊子版への転載だけだった契約を電子版へも拡大し、電子版掲載の契約金額を 1 ページ当たり 2,000 円 (従来は冊子版) から 3,000 円に引き上げ、会誌発行事業の収支改善にも貢献した。

8. 国際事業活動報告 (定款第 4 条第 5 号関係)

(1) 国際会議 ICEP に係る連携関係の明確化

ICEP2014 について、エレクトロニクス実装学会主催、IEEE CPMT Society Japan Chapter 共催とし、IEEE に投稿論文の著作権の一部使用を許諾する MOU (Memorandum of Understanding: 了解覚書) を IEEE と締結した。(開催ごとに都度締結予定) IMAPS については、これとは別に IMAPS との連携に必要な内容に改訂して MOU を締結した。台湾で開催された IMPACT 2014 において、ICEP Session の枠をもらい、日本から 5 名の発表者を送り込み、ICEP との協力体制を築いた。韓国で開催された ISMP 2014 は、IAAC との Joint Conference となり IAAC を最初に開催した日本から支援することにより、ICEP との協力体制を築いた。実装技術の分野で、2 大国際学会となっている ICEP と ICSJ(旧 VLSI Packaging Workshop)の今後の協調に関して意見交換した。

9. 支部事業活動報告 (定款第 4 条第 6 号関係)

(1) 関西支部

① 関西ワークショップ 2014 (2014. 7. 17-18 ラフォーレ琵琶湖)

ナイトセッション (1 日目) では「日本実装業界の将来像」のテーマで、講師 5 名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。2 日目は、特別講演「iPS 細胞への投資を考える; この不思議な細胞は何ができるのか?」(京都大学 iPS 細胞研究所 江藤浩之教授) など 3 講演の後、カーエレ・パワーエレクトロニクス、プリントドエレクトロニクス、

【第1号議案】

3D インテグレーション、基板・部品内蔵など9テーマ分野で30件のポスター発表が行われた。参加者は112名。

②第20回若手研究会 세미나 (2014.6.11 大阪府立大学 I-site なんば)

「パワーデバイスの基礎 ～材料からパッケージ・モジュールまで～」をテーマとして、3講演を行った。受講者は74名。

③「第3回ぷらっと関西」 (2014.11.21 京都大学 iPS細胞研究所)

京都大学「iPS細胞研究所」を見学後、2講演があった。参加者は30名。

④第11回技術講演会、2015.2.20 大阪府立大学 I-site なんば)

「パワーエレクトロニクスの技術動向」をテーマに、パワーデバイスの最先端実装パッケージに関する材料、プロセス、基板構造等の各種要素技術についての4講演があった。参加者は34名。

⑤第21回若手研究会 세미나 (2015.1.13 大阪府立大学 I-site なんば)

「基礎から分かる MEMS -歴史・動作原理から今後の実装技術まで-」というテーマで、MEMSの基本、市場動向、プロセス、実装技術、今後の展開・方向性に関する4講演を行った。受講者は36名。

(2)九州支部

九州大学バイオメカニクス研究センターと合同研究会 (2015.2.6-7 九州大学)を行った。外国人10名、若手研究者30名を含む80名の参加があり、バイオ電子デバイス分野の研究者、アジア地域の研究者をとの交流を推進した。

(3)東北・北海道地区

東北・北海道地区の支部設立に向けた準備作業を進めた。

10. 表彰事業活動報告 (定款第4条第6号関係)

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーション向上のために以下の表彰を行った。

(1)学会賞(1件)

「LSIの三次元集積化技術の研究開発に対する貢献」 小柳光正 (東北大学)

(2)功績賞(1件)

「プリント配線板製造技術分野での業績及び、技術調査事業の運営、役員としての学会運営に対する貢献」 中祖昭士 (大昌電子)

(3)技術賞(2件)

①「半導体プロセスを応用した高信頼性微細配線技術の開発」

神吉剛司、池田淳也、中田義弘、中村友二、谷元昭 (富士通研究所)

②「熔融はんだを使用したはんだバンプ形成技術の研究開発と実用化」

鳥山和重、折井靖光、青木豊広、森裕幸 (日本アイ・ビー・エム)、高口彰 (千住システムテクノロジー)、名内孝、中村秀樹 (千住金属工業)、高橋誠一郎、武川純、長谷川公一 (JSR)

(4)論文賞(2件)

①「高温劣化を考慮したはんだ接合部の疲労寿命予測手法」

河野賢哉、中康弘、谷江尚史 (日立製作所)、木本良輔、山本健一 (ルネサスエレクトロニクス)

②「電気光学結晶 $\text{KTa}_{1-x}\text{Nb}_x\text{O}_3$ を用いた高速光偏向器による波長掃引光源に関する研究と光コヒーレンストモグラフィーへの応用」

佐々木雄三、岡部勇一、上野雅浩、坂本尊、豊田誠治、小林潤也 (日本電信電話)、福田明広、近江雅人 (大阪大学)

(5)功労賞 (2件)

【第1号議案】

- ①雀部俊樹（雀部技術事務所）：「永年にわたる配線板製造技術委員会活動における学会発展に対する貢献」
- ②橋本薫（明星大学）：「永年にわたる英文論文誌編集発行における学会発展に対する貢献」
- (6)マイスター賞（1件）
- ①鈴木斉（日立製作所）：「電子材料の先端めっき技術への貢献」
- (7)春季講演大会表彰
- 第28回講演大会【講演大会優秀賞】（5件）
- ①5A-08：「第4世代移動通信用800MHz・2.0GHz・UWB帯3周波数対応マルチバンドアンテナ」
秋山侑祐、越地福朗（国士舘大学）、越地耕二（東京理科大学）
- ②5B-19：「薄膜キャパシタ内蔵インターポーザ」
服部篤典、小川裕誉（野田スクリーン）
- ③5E-05：「コールドスプレー銅皮膜の強度支配因子評価」
渡邊雄亮、三浦英生（東北大学）
- ④7B-13：「レーザーフラッシュ法による複合高分子材料の熱拡散率測定シミュレーション（定常法測定シミュレーション結果との比較）」
上利泰幸、山田信司、岡田哲周（大阪市立工業研究所）
- ⑤7C-16：「太陽光発電テキスタイルの開発」
増田敦士、辻堯宏（福井県工業技術センター）、中田仗祐（スフェラーパワー）
- 第28回講演大会【研究奨励賞】（5件）
- ①5A-15：「LSI電源系のコモンモードノイズ低減時における電源・グラウンド電圧の位相に関する検討」
松嶋徹（京都大学）
- ②5C-06：「高出力半導体レーザーの高放熱化のための金薄膜を介したGaAs/SiCウェハの低温接合」
奥村拳（東京大学）
- ③5C-13：「高精細・短タクト全印刷トランジスタ形成に向けた一括焼成技術の開発」
日下靖之（産業技術総合研究所）
- ④6B-07：「偏光レーザーの散乱情報を用いた表面粗さ検査」
劉臨生（産業技術総合研究所）
- ⑤7B-03：「放射光X線ラミノグラフィによるFBGAはんだ接合部の熱疲労き裂進展評価」
花村拓哉（富山県立大学）
- 第29回講演大会【ポスターアワード】（2件）
- ①16P1-1：「Sn-Bi-Cu合金の引張特性に及ぼす冷却速度の影響」
大山拓人（群馬工業高等専門学校）
- ②16P1-11：「ゲート絶縁膜表面電位による有機トランジスタのしきい値電圧操作」
平田郁恵（東京大学）
- (8)秋季大会MES2014表彰
- 【ベストペーパー賞】（5件）
- ①1A2-4：「高熱伝導・熱応力緩和性を有するアルミニウム/グラファイト積層ロール型複合材の開発」
山田由香、北條浩、木村英彦、川本敦史、松森唯益、近藤継男（豊田中央研究所）
- ②2A3-5：「NiPめっき/Sn-Cu系はんだ接合部のエレクトロマイグレーション現象」
門口卓矢（トヨタ自動車）、後藤圭亮、山中公博（中京大学）
- ③2B2-2：「水素ラジカル処理したはんだを用いた低温固相接合技術の開発と気密封止パッカー

【第1号議案】

ジングへの応用」

日暮栄治、川合紘夢、須賀唯知（東京大学）、岡田咲枝（千住金属工業）、萩原泰三（神港精機）

④2B3-3：「磁界により Sn 結晶方位を配向するはんだ接合部の高信頼化技術」

山中公博、田口博久（中京大学）、西川宏（大阪大学）、原田美由紀、越智光一（関西大学）

⑤2D2-5：「Si/Cu 同時研削と残留金属低減処理を用いた微細 TSV 露出工程の開発」

渡辺直也、青柳昌宏（産業技術総合研究所）、片川大輔（アプリシアテクノロジー）、三井貴彦、山本栄一（岡本工作機械製作所）

【研究奨励賞】（5 件）

①1A1-4：「ラマン分光法を用いた SiC MOSFET の応力の温度依存性評価」

内田智之（東レリサーチセンター）

②1B1-4：「銅のエッチングレートに結晶方位が与える影響」

久保田賢治（三菱マテリアル）

③1C1-1：「電源供給網反共振ピークのオンボード抑制手法」

山口冬生（芝浦工業大学）

④2C1-3：「接着剤併用型 Sn-Bi はんだペーストの開発」

北村和大（富士通クオリティ・ラボ）

⑤2C4-5：Embedded Wafer Level BGA パッケージの落下衝撃信頼性におよぼすポリイミド再配線層の影響」

下田秀治（芝浦工業大学）

(9) ICEP2014 表彰

【ベストペーパー賞】（4 件）

①WE1-2：“Basic Study on Flow and Heat Transfer Performance of Pulsating Air Flow for Application to Electronics Cooling”

Mutsuki Kichima, Takashi Fukue, Koichi Hirose (Iwate University / Japan)

②TA1-3：“Process Integration of 3D Stacking for Backside Illuminated Image Sensor”

Zhi-Cheng Hsiao, Cheng-Ta Ko, Hsiang-Hung Chang, Huan-Chun Fu, Chao-Kai Hsu, Shu-Man Li, Wen-Li Tsai, Wen-Wei Shen, Jen-Chun Wang, Yu-Min Lin, Wei-Chung Lo (Industrial Technology Research Institute / Taiwan)

③TB1-3：“Development of Fine Pitch Negative Tone Resist for Electro-Plating”

Hisanori Akimaru, Hidefumi Ishikawa, Hirokazu Sakakibara, Shingo Naruse, Kenji Okamoto, Katsumi Inomata (JSR / Japan)

④FB2-2：“Solder Crack Simulation using SPH Particle Method with Sub-modeling Technique”

Chihiro J. Uchibori¹, Seiki Sakuyama¹, Yuzuru Sakai², Thyon Su-I², Takayuki Watanabe², Nobuki Yamagata³ (1Fujitsu Laboratories, 2Yokohama National University, 3Advanced Creative Technology / Japan)

【ポスターアワード】（1 件）

①Poster-09：“Hemocompatibility of DLC Coating for Blood Analysis Devices”

Keisuke Shib¹, Yasuharu Ohgoe¹, Kenji Hirakuri¹, Jun Mizuno², Shuichi Shoji², Kazuhide Ozeki³, Keisuke Sato⁴, Naoki Fukata⁴, Ali Alanazi⁵ (1Tokyo Denki University, 2Waseda University, 3Ibaraki University, 4International Center of Materials Nanoarchitectonics / Japan, 5King Saud University / Saudi Arabia)

11. その他の活動報告（定款第 4 条第 5 号関係）

【第1号議案】

(1) 関連学協会の各種事業との協力活動

電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会、溶接協会、表面技術協会など 23 学協会、36 件の講演大会・シンポジウムなどの行事について協賛・後援した。一方、秋季大会 MES および春季講演大会では 23 学協会から協賛を受けるなど、相互に交流を深めた。Mate2015、MES2014 については特に関連深いスマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会との共催で実施した。また、支部レベルでは、関西にある他の学協会支部と相互に協賛を行い活動の活性化に寄与した。

12. 平成 27 年 3 月 31 日現在の会員数

正会員	2,356 名	(前年同期比 19 名減)
学生会員	182 名	(前年同期比 12 名減)
賛助会員	152 社	(前年同期比 3 社減)
賛助会員口数	313 口	(前年同期比 3 口減)